

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL  
CORPORATION**

**中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 \***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00981)

**海外監管公告**

本公告乃中芯國際集成電路製造有限公司（Semiconductor Manufacturing International Corporation, 「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《中芯國際集成電路製造有限公司關於 2021 年度對外擔保額度預計的公告》，僅供參閱。

承董事會命

中芯國際集成電路製造有限公司

高永崗

執行董事、首席財務官兼公司秘書

中國上海， 2021 年 3 月 31 日

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

周子學（董事長）

蔣尚義（副董事長）

趙海軍（聯合首席執行官）

梁孟松（聯合首席執行官）

高永崗（首席財務官兼公司秘書）

**非執行董事**

陳山枝

周杰

任凱

路軍

童國華

**獨立非執行董事**

William Tudor Brown

劉遵義

范仁達

楊光磊

劉明

\* 僅供識別

A股代码：688981

A股简称：中芯国际

公告编号：2021-009

港股代码：00981

港股简称：中芯国际

## 中芯国际集成电路制造有限公司

### 关于2021年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- **被担保人：**被担保人为公司全资子公司和非全资控股子公司，其中全资子公司为中芯集电投资（上海）有限公司、中芯国际控股有限公司、中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司、中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司、中芯国际集成电路新技术研发（上海）有限公司、芯电半导体（上海）有限公司，非全资控股子公司为中芯京城集成电路制造（北京）有限公司。
- **本次担保金额及实际担保余额：**公司预计2021年度为子公司提供新增担保额度合计不超过人民币（或等值外币）4,700,000.00万元。截至2021年2月28日，公司已实际为本次担保对象提供的担保余额为1,285,417.44万元。
- **本次担保是否有反担保：**否
- **本事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会进行审议。**

## 一、担保情况概述

### （一）担保基本情况

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）根据其业务发展规划，并结合子公司的实际需求，预计2021年度为全资子公司和非全资控股子公司提供新增担保额度合计不超过人民币（或等值外币）4,700,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	担保额度	公司持股比例
1	中芯集电投资（上海）有限公司	1,500,000	100%
2	中芯国际控股有限公司	20,000	100%
3	中芯国际集成电路制造（上海）有限公司	800,000	100%
4	中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	800,000	100%
5	中芯国际集成电路制造（天津）有限公司	500,000	100%
6	中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司	500,000	100%
7	中芯国际集成电路新技术研发（上海）有限公司	20,000	100%
8	芯电半导体（上海）有限公司	10,000	100%
9	中芯京城集成电路制造（北京）有限公司	550,000	51%
	合计	<b>4,700,000</b>	

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对所属全部全资及非全资控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，分别在上述全资子公司或非全资控股子公司的新增担保额度内调剂使用。

### （二）本次担保事项履行的审议程序

公司于2021年3月31日召开董事会会议，审议通过了《关于2021年度对外

担保额度预计的议案》。根据公司《经修订及重述组织章程大纲及章程细则》及《对外担保管理制度》的相关要求，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。上述担保预计额度有效期为董事会审议通过之日起12个月。

## 二、被担保人基本情况

### （一）中芯集电投资（上海）有限公司

1、成立日期：2003年9月30日

2、注册资本：46,580万美元

3、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张江路18号

4、法定代表人：周子学

5、经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；集成电路相关电子产品的研发、生产（由分支机构经营）；受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：（1）协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；（2）在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；（3）为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；（4）协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；承接其母公司和关联公司的服务外包业务；集成电路产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、主要财务数据：

单位：千元

类别	2020年度（未经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	37,570,906	37,250,892
负债总额	5,999,951	4,282,133
资产净额	31,570,955	32,968,759

营业收入	365	365
净利润	-29,863	-8,055

(二) 中芯国际控股有限公司

1、成立日期：2015年7月28日

2、注册资本：5,000万美元

3、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区丹桂路1059号1幢

4、法定代表人：赵海军

5、经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所提供企业提供下列服务：（1）协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；（2）在外汇管理系统部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；（3）为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；（4）协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新科技的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；承接其母公司和关联公司的服务外包业务；集成电路产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务；自有物业出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、主要财务数据：

单位：千元

类别	2020年度（未经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	36,912,710	33,253,480
负债总额	37,484,438	33,896,858
资产净额	-571,728	-643,378
营业收入	1,623	559
净利润	-705,088	-671,798

(三) 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司

1、成立日期：2000年12月21日

2、注册资本：244,000万美元

3、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张江路18号

4、法定代表人：赵海军

5、经营范围：半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装，销售自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、主要财务数据：

单位：千元

类别	2020年度（未经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	57,177,478	52,765,914
负债总额	40,853,064	36,179,504
资产净额	16,324,414	16,586,410
营业收入	9,752,030	7,624,092
净利润	1,474,089	1,048,563

（四）中芯国际集成电路制造（北京）有限公司

1、成立日期：2002年7月25日

2、注册资本：100,000万美元

3、注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道18号

4、法定代表人：赵海军

5、经营范围：半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片的制造、针测及测试、光掩膜制造；与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、测试封装；销售自产产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、主要财务数据：

单位：千元

类别	2020年度（未经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	143,070,211	146,116,406
负债总额	126,740,110	129,499,037
资产净额	16,330,101	16,617,369
营业收入	12,586,749	9,749,475
净利润	2,247,224	1,844,974

(五) 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司

- 1、成立日期：2003年11月3日
- 2、注册资本：129,000万美元
- 3、注册地点：天津市西青经济开发区兴华道19号
- 4、法定代表人：赵海军

5、经营范围：半导体(硅片及各类化合物半导体)集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装，销售自产产品、及以上相关服务；自有房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、主要财务数据：

单位：千元

类别	2020年度(未经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	12,693,151	12,803,441
负债总额	4,440,756	4,298,971
资产净额	8,252,395	8,504,470
营业收入	3,126,167	2,281,585
净利润	552,914	447,568

(六) 中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司

- 1、成立日期：2008年3月20日
- 2、注册资本：110,000万美元
- 3、注册地点：深圳市坪山区龙田街道出口加工区高芯路18号
- 4、法定代表人：赵海军

5、经营范围：半导体(硅及各类化合物半导体)集成电路芯片制造、针测及测试、测试封装，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、销售自产产品。

6、主要财务数据：

单位：千元

类别	2020年度(未经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	7,179,915	6,753,898
负债总额	1,404,404	1,814,617
资产净额	1,522,664	1,154,609
营业收入	-918,899	-578,681



净利润	7,179,915	6,753,898
-----	-----------	-----------

(七) 中芯国际集成电路新技术研发(上海)有限公司

1、成立日期: 2014年10月28日

2、注册资本: 40,000万美元

3、注册地点: 中国(上海)自由贸易试验区张江路18号3号楼6楼

4、法定代表人: 高永岗

5、经营范围: 集成电路的制造、技术开发、技术咨询、技术服务、自有技术转让、销售自产产品, 从事上述相关产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外), 并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、主要财务数据:

单位: 千元

类别	2020年度(未经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	2,821,400	3,252,670
负债总额	1,499,317	1,872,029
资产净额	1,322,083	1,380,641
营业收入	38,409	32,666
净利润	-135,589	-133,695

(八) 芯电半导体(上海)有限公司

1、成立日期: 2009年3月3日

2、注册资本: 1,200万美元

3、注册地点: 中国(上海)自由贸易试验区张江路18号2号楼1楼-1

4、法定代表人: 赵海军

5、经营范围: 半导体(硅片及各类化合物半导体)集成电路芯片制造、针测及测试, 与集成电路有关的开发、设计服务、光掩膜制造、测试封装、销售自产产品。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、主要财务数据:

单位: 千元

类别	2020年度(未经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	4,139,638	4,215,442
负债总额	4,133,277	4,301,466
资产净额	6,361	-86,024

营业收入	0	0
净利润	212,032	144,558

(九) 中芯京城集成电路制造(北京)有限公司

1、成立日期：2020年12月7日

2、注册资本：500,000万美元

3、注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道18号9幢一层1069室

4、法定代表人：姜镭

5、经营范围：制造12英寸集成电路圆片、集成电路封装系列；技术检测；与集成电路有关的技术开发、技术服务、设计服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、主要财务数据：

单位：千元

类别	2020年度（未经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	8,039,149	0
负债总额	641,434	0
资产净额	7,397,715	0
营业收入	0	0
净利润	-1,326	0

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

担保对象中芯京城集成电路制造(北京)有限公司为公司非全资控股子公司，公司持股比例为51%，其余少数股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股24.49%、北京亦庄国际投资发展有限公司持股24.51%。考虑到上述股东自身性质及业务实操的便利性，本次担保将由公司提供超出持股比例的担保，其他少数股东未提供同比例担保。

#### 四、担保的原因及必要性

上述担保事项有助于提高公司融资与结算业务的运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的全资子公司或非全资控股子公司，担保风险总体可控。

#### 五、董事会意见

董事会认为：上述担保事项有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2021年2月28日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为1,433,316.01万元（已经汇率折算），其中公司为控股子公司提供的担保总额为147,898.57万元（已经汇率折算）。累计对外担保总额及为控股子公司提供的担保总额分别占公司最近一期经审计总资产的比例不超过7.01%、0.72%，占公司最近一期经审计归母净资产的比例不超过14.46%、1.49%。公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。

公司无逾期担保的情况，涉及诉讼的担保金额为0元。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2021年4月1日